

PIASTRA DI SALDATURA



Piastra calda a conduzione per la saldatura o la rilavorazione delle schede elettroniche.

La piastra viene principalmente utilizzata per la saldatura di componenti su substrati di ceramica oppure per la rilavorazione di componenti montati sui metalcore. Dove ci sono grandi dissipazioni termiche, la piastra trova un impiego ottimale rispetto a qualsiasi altro metodo di rilavorazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Principio di funzionamento	Conduzione termica
Dimensione area di riscaldamento	200 x 120 mm
Potenza elettrica	600 w
Alimentazione elettrica	220 V a.c. 50/60 Hz.
Massima temperatura impostata	300° C
Sistema di controllo temperatura	PID
Tempo di allarme	Da 1 a 99 minuti
Dimensione macchina	(L) 310 mm x (W) 280 mm x (H) 145 mm
Peso	7,8 kg
Dimensione imballo	(L) 370 mm x (W) 360 mm x (H) 220 mm

Fasi operative:

1. Accendere l'interruttore di alimentazione dell'apparecchiatura, impostare i parametri di temperatura sul termoregolatore, (saldare la sfera di saldatura, 220-240 gradi / saldatura senza piombo, 245-265 gradi)
2. Utilizzare il saldatore per pulire i cuscinetti di bga e PCB, utilizzare lo stoppino di saldatura per trascinare il cuscinetto.
3. Usare il detergente speciale o i residui di flusso di pulizia dell'alcool industriale.
4. Sulle superfici del cuscinetto di BGA, PCB, rivestite con una piccola quantità di pasta di saldatura uniformemente tamponata, assicurare il legame e favorire l'effetto di saldatura.
5. Scegli la sfera di saldatura corrispondente al chip BGA, quando le saldatrici mostrano la temperatura effettiva e la temperatura impostata rimane invariata, metti il chip BGA che termina il reballing su un panno resistente alle alte temperature, quindi posizionali sulla piastra di riscaldamento sinistra, imposta il tempo corrispondente, quindi premi il pulsante di avvio per riscaldare.
6. Osservare se le tendenze della sfera di stagno e il cuscinetto continuano a corrispondere.
7. Quando mantieni la corrispondenza, metti il chip BGA sulla piastra di raffreddamento a destra.
8. Dopo il raffreddamento della sfera di saldatura, se sulla superficie è presente una sbavatura, pulire la pasta e riscaldare nuovamente.
9. Rimuovere il chip BGA che termina il processo di reballing, quindi spegnere l'alimentazione.



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>